

2023 年度通期決算説明会（2024 年 4 月 26 日開催）

QA 要旨

Q1. 商談獲得について、昨年度（2023 年度）獲得したものは、量産に寄与するまでどれくらいの時間がかかると見ておけばよいのでしょうか。今後 2 年概ね売上が横ばいとの見通しは変わっていないということでしたが、この 2 年の間に量産で寄与する案件はないのでしょうか。また昨年度獲得した商談の収益性は、これまでのものと比べて変化はありますか。

A1. 昨年度獲得した商談は、地域では米国向け、アプリケーションでは自動車向けが多くなっています。自動車向けは量産までの期間が他のアプリケーションより長く、量産に寄与するのは 2027 年以降になると見ています。自動車向け以外では、スマートデバイス向けやデータセンター・ネットワーク向けの商談も獲得していますが、これらも量産化は主に 2026 年、2027 年からと見ています。2024 年度、2025 年度の見通しについては、昨年秋に主として既存商談を中心に見直しを行い、これをもとにすでにご説明していますが、その時点から見通しは概ね変わっていません。昨年秋以降に獲得した商談で、2024 年度、2025 年度に売上寄与するものはほぼないと思います。

昨年度獲得した商談の収益性については、既存の特需の製品は原価率が他の製品に比べ高めですが、そのようなことはないと思います。ただ、今後期待しているデータセンター向けの大型商談などは、現状より原価率が高くなると思いますが、売上の規模拡大によって全体の利益率が、これにより改善することを期待しています。

Q2. 特需のビジネスについて、3ヶ月前、半年前の見通しと大きく変わっていないのでしょうか。2026 年以降についてもどう見ているのでしょうか。

A2. 変わっていません。2024 年度、2025 年度の見通しは、昨年の秋時点でご説明した見通しに織り込んでおり、その時点から現在に至るまで大きな変化はありません。

2026 年以降はお客様次第でよくわからないところがありますが、2026 年以降は特需以外の要素が成長をリードしていくので、いずれにしろ現在見通している 2026 年以降のシナリオに大きな影響を与えることはないだろうと思います。

Q3. 2024年度の市場予想のスライドで「スマートデバイス向け既存製品の需要増」という説明がありますが、デジカメなど在庫調整との見方も出ていて、今期の見通しが下振れとなるリスクはないでしょうか。

A3. ご指摘の通り、国内市場向けはカメラや事務機など在庫調整局面が続いていると思いますが、海外向けでは需要増が期待できるお客様もあると見ています。

Q4. 北米のデータセンター向けの商談について、商談が本格化しているとの説明がありましたが、商談獲得の手応えは感じていますか。

A4. まだ、正式な商談獲得には至っていないものの、商談が本格化しているということは言えると思っています。これは、自動車向けの先端分野での実績や昨年公表したようにパートナーと協力し2nmのテストチップを開発する、さらに北米でのリソースを強化することなど、これまでの取組みの成果があらわれることを期待しています。商談本格化の手応えを感じています。

Q5. 北米のデータセンター向けの商談については、上流設計込みの商談との話でしたが、北米のデータセンターのお客様は、アーキテクチャーは自分達で設計して、物理設計のところだけを外注するニーズが多いと考えていますが、今後は上流設計込みの商談が増えていくと見ていますか。また、北米のデータセンター向けのビジネスの拡大は、商談を獲得したお客様の中で、更に他の案件を取っていかようとしているのでしょうか、それとも新たなお客様の数を増やしていくイメージでしょうか。

A5. 現在進めているデータセンター向けの商談は上流設計込みの商談ですが、勿論バックエンド設計だけの商談もあり、それができる競争力を持っている必要があると考えています。ただデータセンター向けに必要なプロセッサやSoCは多様化してきており、カスタムSoCの対象となるチップの種類も量も確実に増えていて、お客様がどこまで自前でやるかという問題があります。そういう意味では、当社のソリューションSoCのモデルの商談機会がデータセンター向けでも増えていくと考えています。ビジネスの拡がりについては、商談を獲得したお客様の中で他の案件も獲得していくこと、更に新たなお客様を増やしていくこと、その両方をやっていきたいと考えています。

Q6. 現在進めている北米データセンター向けの商談は、昨年発表された2nmプロセスを使った製品なのでしょうか。

A6. 現在進めている商談は、3nmの製品です。2nmプロセスのものはもう少し先になると考えています。

Q7. 獲得商談のキャンセルについて、説明がありましたが、今後 先端技術製品の比率拡大やアプリケーションの多様化により、キャンセルのリスクが高まる懸念はないでしょうか。

A7. 昨年度はキャンセルが発生しましたが、これまで獲得の商談獲得残高の総累計を見るとほぼ当初獲得残高を維持しています。キャンセルで減少した分を他の増加が補って、ほぼ当初獲得金額を維持しています。キャンセルの要因は様々ありますが、商談獲得段階でそのリスクを十分見極めた上で獲得する努力をしています。また、大型案件の増加に伴い、リスクヘッジのためにも引き続き、できるだけ多くの案件を獲得していきたいと思っております。

Q8. 昨年度の商談獲得金額は、目標としていた約 2,500 億円を達成しましたが、今期の目標はどう設定しているのでしょうか。現在進めているデータセンター向けの商談が獲得できると、その規模にもよりますが昨年度の水準より一段上がると見た方がよいのでしょうか、昨年度と同水準の金額を維持していくと見ておくべきでしょうか。

A8. 今年度の商談獲得金額としては、まず昨年度の約 2,500 億円を、そして更にこれを上回ることを目指したいと考えています。商談獲得残高を見ると、データセンター向けの商談が伸びていないので、重点4分野でバランスが取れた構成にしていきたいとも思っています。

Q9. 生成 AI を自動車にも載せるという要求が自動車メーカーから出てきていると思いますが、これにより御社にはどのような影響があるのでしょうか。

A9. 生成 AI の影響は自動車にも出ています。生成 AI を含めた AI の処理能力を上げるために AI アクセラレーターを搭載する、あるいは GPU の処理能力、性能を上げる、これが自動車向けのカスタムチップをつくる大きな動機になっています。このトレンドは自動車分野だけでなく広く産業分野でも見られ、AI 活用のために先端 SoC や先端技術を必要としています。これが当社であらためて産業分野を重点分野の一つとした背景でもあります。

Q10. チップレットやヘテロジニアスインテグレーション（異種チップ集積）の技術を使った製品はこれから増えてくるのでしょうか。

A10. 増えると思っています。現在は、ホモジニアスインテグレーション（同種チップ集積）の製品が多いと思いますが、ヘテロジニアスインテグレーションへのお客様の関心は高まっています。ただ、設計の難易度も増しており、システムレベルの技術だけでなく様々なインターフェース（接続技術）も重要になっています。当社では、多分野・多品種の "Entire Design"（全体設計）を手がける "Solution SoC" モデルに最適な設計開発プラットフォームを構築し、チップレットを含めてこれらの技術に対応した製品の設計、量産への取組みを強化しています。

Q11. 様々な IP や回路ブロックを組み合わせ、その性能を引き出す技術が強みとの説明がありました。御社で差別化を図るため独自に IP を開発する考えはあるのでしょうか。

A11. 当社のビジネスモデルは、市場で調達可能な IP や技術を最大限使いこなしていくことを基本としており、最近ではエコシステムの進化や拡大で、市場で IP のアベイラビリティが高くなっています。また、SoC には多様な IP が必要となっています。一般的に、外部から購入する IP 比率が上がってきています。もちろん必要な IP については、自社で開発する、あるいは IP ベンダーと緊密に連携することなども必要だと考えています。

以上